

# Technisches Datenblatt

## Vakuum-Metallisierung

EMV-Abschirmung

**CuCrNi-Bedampfung**



**Verfahren:**

Vakuum-Metallisierung  
nach dem PVD-Verfahren  
(Physical Vapor Deposition)

**Einsatzmaterial:**

CU/NiCr  
- Kupfer Cu 1,5 – 3 µm,  
- Nickel-Chrom NiCr 0,15 µm  
dreiwertiges Chrom Cr (III)

**Einsatzmöglichkeit:**

fast alle Kunststoffe,  
Metalle, Glas

**Schichtdicke:**

1,5 bis 3 µm

**Dämpfung:**

60 bis 80 dB  
(z.B. bei Kunststoffen 30 MHz bis 1 GHz)

**Dichte:**

8,92 g/cm<sup>3</sup>

**Elektr. Leitfähigkeit:**

59,1 x 10<sup>6</sup> A/Vm

**Schmelzpunkt:**

1084° C

**Wärmeleitfähigkeit:**

400 W / (mK)